

PA-1450-30LS SPECIAL ASSEMBLING INSTRUCTION

REV: A

一. 安規要求：	Remark
1.1 a.)C051正極端線腳不可與HS1接觸 1.2 須確保鉚合後效果穩固, 不可以脫落 1.3 其餘未註明項目, 請參考點膠圖面	
二. 客戶要求：	
2.1 零件剪腳後需全部補焊. 2.2 補焊後需清除錫球,且須使用放大鏡全檢是否殘留錫球.	
三. 設計性要求：	
3.1 SMD零件及出腳, 腳長不得超過 2.3 mm. 3.2 FRPP組裝時需將定位片裝入後，再裝下鋁套 ，J1、J2魚叉PIN焊接後不可造成下鋁套浮件。 3.3 SMD 與 DIP 點膠請參考附件圖面 3.4 INLET的 L/N/FG線組裝順序,請參考附件圖面 3.5 Thermal Pad貼覆方式,請參考附件圖面	
四. 其他要求：	
4.1 Q050 焊錫腳須以銅刷清錫珠. 4.2超音波熔合外殼後：上蓋需與下蓋殼邊距離0.2+/-0.2mm，推力為 50KGF (min). 4.3 組裝CASE時, 先裝下蓋, 再裝上蓋. 4.4 T050 變壓器的 PIN 腳, 過完錫爐後，焊錫不良者要補焊. 4.5 下蓋下沉尺寸為-0.15~-0.3mm 4.6 DC CORD端中縫單邊 <0.5mm 4.7 INLET與CASE已設計防呆,請產線人員特別注意INLET組裝方向 4.8 鉚合後, 大口端上方gap不可大於0.3mm，其餘三邊gap不可大於0.4mm	

Fig.1



錫面膠重約 : 3.05 g(min)

1. D050周圍溫度延伸 : D050本體&C001 PIN腳
2. 小板PIN HEADER腳需點膠(如左圖)
3. Thermal Pad 請貼附在框線內
4. 橫跨一、二次側點膠
5. PC300處點膠

Fig.2



零件面膠重約 : 8.53 g(min)

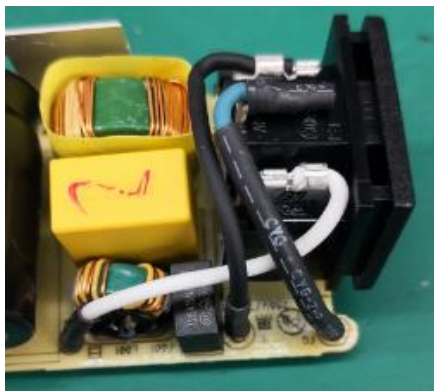
1. C003與L002之間點膠
2. L001側面點膠
3. L002上方點膠
4. C051&HS1之間點膠
5. Q050&C051&T050&FRPP之間點膠
6. Q050&T050&C002&FRPP之間點膠
7. F001 上方不可點膠
8. T050 上方點膠
9. C204&T050&S1小板之間點膠

Fig.3



T050插件前底部需點膠： 請於PCB上T050位置的絲印框內點膠  
T050底部點膠量,根據目前自動點膠的基礎上再加大點膠量

Fig.4



INLET的 L/N/FG焊線組裝順序如下:  
N(白) → FG(藍) → L(黑)